

2009年4月30日

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー

富士通マイクロエレクトロニクスと TSMC、 先端プロセステクノロジーで協力

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社（代表取締役社長：岡田晴基、本社：東京都新宿区、以下、富士通マイクロエレクトロニクス）と台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（社長 兼 CEO：リック・ツァイ、本社：台湾新竹、以下、TSMC）は先端プロセステクノロジーを用いた富士通マイクロエレクトロニクス製品の製造で協力します。この合意で、富士通マイクロエレクトロニクスは TSMC へ 40 ナノメートル（以下、nm）世代のロジック IC の製造を委託し、ビジネスを展開いたします。

富士通マイクロエレクトロニクスが保有する設計技術および画像・通信に関する IP（注 1）、さらに日本を中心とするお客様に対する質の高い技術サポートと、TSMC の専門ファウンドリ生産能力を結びつけることによって、両社は新しいビジネス、顧客を創出してまいります。

また両社は、富士通マイクロエレクトロニクス向けに 28nm 世代以降の高性能テクノロジーの共同開発を行うことにつきまして、これから協議を開始いたします。

富士通マイクロエレクトロニクスの代表取締役社長 岡田晴基は、次のようにコメントしています。「TSMC は、プロセスの先進性および大規模生産能力という面で最も魅力的なファウンドリパートナーです。このパートナーシップにより当社は微細化プロセスに関する強みを継続的に維持し、当社が注力する ASIC、ASSP 事業において、さらなる成長が可能になるものと考えます。」

TSMC の社長 兼 CEO リック・ツァイは次のようにコメントしています。「富士通マイクロエレクトロニクスは、高速・低消費電力テクノロジーの先進性および卓越した設計技術・差異化された IP において世界のリーダーです。継続した投資で先端プロセステクノロジーに専念し、長年にわたり日本の半導体マーケットにコミットしている当社 TSMC と富士通マイクロエレクトロニクスが協力することで、多くのシステム会社に最高のソリューションを提供できると考えます。」

【関連リンク】

富士通マイクロエレクトロニクス<http://jp.fujitsu.com/microelectronics/>

【商標について】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

【注釈】

(注1) 一般的には知的財産権のことを指すが、ここではシステムの機能を実現する回路ブロック、ファームウェア、ミドルウェアなどのことです。

以 上

【報道機関お問い合わせ先】


富士通株式会社

お問い合わせフォーム：<http://pr.fujitsu.com/jp/news/q.html>

TSMCジャパン株式会社

プレスセンター

株式会社イーアンドイー内

 電話：0422-30-8800